



大学祭応援！

キャンペーン



あなたの大学祭、一緒につくりませんか？

応募期間

■第1期
2026 7.01 WED
|
2026 8.13 THU

・商品送付 8月下旬～9月上旬
・抽 選 10団体程度

■第2期
2026 8.14 FRI
|
2026 9.30 WED

・商品送付 10月中旬～10月下旬
・抽 選 10団体程度

協賛商品

A 出店ブース製作 応援プラン



・ボンド 木工用 500g 10本
・ボンド ウルトラ多用途SUクリアー 120ml 15本

B サンプルング 協賛プラン



・ボンド 裁ほう上手スティック 6ml 30本
・ボンド ウルトラ多用途SUクリアー 25ml 20本

ご応募の流れ

STEP
1

応募フォームから応募

以下URLもしくはQRコードから応募フォームにアクセスし、必要事項を入力のうえご応募ください。

応募フォームURL

<https://forms.cloud.microsoft/r/WqgevrPhH4>

応募フォームQRコード



STEP
2

商品協賛可否をご連絡

抽選後、協賛可否をメールにて回答させていただきます。
協賛可否メールに提出いただくレポートのフォーマットを添付いたします。



STEP
3

商品が届く

ご指定の場所に、商品をお送りします。
ボンド商品で学園祭をもっと楽しいものに！

最後にお願い！ レポートのご提出

協賛商品を使用した製作物の写真や、サンプリングの様子の写真とレポートをご提出ください。

※送付するフォーマットに記入して提出してください。

応募条件

●大学祭及びそれに準じるイベントに参加される団体様

実行委員会に限らず、サークルや部活でブース等を製作する団体様も対象です。
以下の場合は協賛条件に当てはまりませんので、予めご了承ください。

- ・中学・高校・専門学校で実行予定の団体様
- ・日本国外にて大学祭を実行予定の団体様

●送付期間で活用できる団体様

協賛商品の送付期間の変更はできません。

●写真とレポートの提出がOKな団体様

協賛商品を使用して製作したブースやサンプリングしている様子の写真とレポートのご提出をお願いいたします。いただいた写真は弊社HP・SNS等で公開させていただく場合がございます。

レポートの提出期限は2026年12月31日となります。提出期限までにレポートをご提出いただけない団体様には協賛できかねます。

●1団体につき1回だけの協賛

協賛商品の数には限りがございますので、予めご了承ください。

注意事項

●個人情報について

お申し込み時に入力いただくメールアドレス・連絡先・住所は、協賛時のご連絡と商品発送の目的で使用いたします。法令等に基づく場合を除き、ご本人の同意がない限り個人情報を第三者に対して開示することはありません。

●写真・レポートについて

ご送付いただいた写真やレポートについては、弊社HP・SNS等で公開させていただきます場合がございます。HPやSNSに投稿しても問題ないものをご送付ください。大学の許諾が必要な場合、事前に許可をもらってからご送付ください。ご送付いただいた写真やレポートは返却できかねますので、予めご了承ください。



コニシ株式会社

ホームページ <https://www.bond.co.jp/>

関東支社 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀5-3-35 TEL.048 (637) 9952

本キャンペーンに関してのお問い合わせはこちらから

t-kikaku_5730@bond.co.jp